PAT-NO: DOCUMENT-IDENTIFIER: JP355117587A JP 55117587 A

TITLE:

LASER WORKING APPARATUS September 9, 1980

PUBN-DATE: Sep

INVENTOR-INFORMATION: NAME

NAME INAGAKI, MASATOSHI JINBO, RYUTARO UNNO, TOMIO SHIDA, TOMOHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME HITACHI LTD

IKEMOTO, NORIO

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP54024473

APPL-DATE:

March 5, 1979

INT-CL (IPC): B23K026/00, C21D001/09, C21D001/34

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the <u>laser</u> light of an even energy density distribution with the compact constitution of less number of reflecting mirrors by forming the reflecting mirror <u>surface for laser condensing into the curved</u> face comprising moving the polygonal line of the specified angle parallel along the quadratic curve orthogonal to this and being concave to the concave part side thereof

CONSTITUTION: At the time of working, particularly heat-treating the work by radiating <a href="laser">laser</a> light, a reflecting mirror which condenses <a href="laser">laser</a> light onto the work is made into the intersecting quadratic reflecting mirror. More specifically, the concave curved face made when the polygonal line <a href="CO<SB>1</SB>D">CO<SB>1</SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">SB>D">

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO&Japio

# (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

7217-4K

昭55—117587

⑤Int. Cl.³
B 23 K 26/00
// C 21 D 1/09
1/34

識別記号 庁内整理番号 6570-4E 7217-4K 砂公開 昭和55年(1980)9月9日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

例レーザ加工装置

②特

願 昭54-24473

20出 願 昭54(1979)3月5日

70発 明 者 稲垣正寿

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

仰発 明 者 神保龍太郎

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 海野富男

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

70発 明 者 志田朝彦

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

仰発 明 者 池本徳郎

日立市国分町1丁目1番1号株 式会社日立製作所国分工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫

明 細 書

発明の名称 レーザ加工装置

# 特許請求の範囲

- 1. レーザ光を反射鏡を介して被加工部材上に集 光させるレーザ加工装置において、前記反射鏡 は、所定の角度で交叉する折線を、該折線と直 交し、該折線の凹部側に凹な2次曲線に沿つて 平行移動させたときに形成される凹面(以下、 交叉2次曲線と称する)を反射面として有する ことを特徴とするレーザ加工装置。
- 2. 特許請求の範囲第1項において、前記反射鏡からのレーザ光をさらに平面反射鏡を介して被加工部材上に集光させるように構成したことを 特徴とするレーザ加工装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項において、被加工部材 上のレーザ光を振動させるために、前記反射鏡 の少なくとも1つに振動付与手段を設けたこと を特徴とするレーザ加工装置。
- 4. レーザ光を反射鏡を介して被加工部材上に集 光させるレーザ加工装置において、反射鏡は、

所定の角度で交叉する折線を該折線の交点と直交する直線に沿つて平行移動させたときに形成される凹の反射面(以下、交叉1次曲面と称する)を有するものと、少なくとも1方向が2次曲線の曲率を有する凹面鏡との組合わせからなることを特徴とするレーザ加工装置。

5. 特許請求の範囲第4項において、加工部材上のレーザ光を振動させるために、前記反射鏡の少なくとも1つに振動付与手段を設けたことを特徴とするレーザ加工装置。

### 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光を被加工部材に照射して加工するレーザ加工装置に関し、特に熱処理加工を行なり際に、均一なエネルギ密度分布を有するレーザビームを得ることのできるレーザ加工装置に関する。

レーザ発振器から取り出されたレーザ光のエネルギ密度は、発振器の特性に応じて種々のモードで従つた分布を有する。 手 E Moo (ガウス形)のレーザ光の場合を例にとると、第1図に示すごと

(1

(2)

く、ビーム断面10の中心部に高いエネルギ密度 を有し、中心から離れるに従つてエネルギ密度は 指数関数的に低下する。第2図に示すどとく、と のようなレーザ光9を集光レンズ12でいつたん **集光したのち、集点面13からずれた位置の被加** 工部材14に照射すると、第3図に拡大して示す ように、等温度線16は、照射部中心から同心円 的円弧部群となつて拡がる。との等温度線の温度 T, ~T。は周辺部になる程低く(T, <T。< T, <T。)、表面のある領域を一定温度に均一 に加熱することができない。例えば焼入れ加工に おいて、T。を焼入れ温度とすると、中心部のみ 焼入れすることができるが、焼入れ深さが均一に ならず、また周辺の部分18のレーザ光のエネル ギは焼入れに寄与しないため、熱処理効率(焼入 れ体積/(出力×時間)が低下するという欠点を 有している。

上記熱処理加工の欠点を解消する方法として、 第4図(A)に示すごとく、レーザ光を2分割し、 個々のレーザ光を、エネルギ密度分布がX方向で

(3)

等のように空間的に制約のある場合、その使用が 困難であるという欠点を有している。

本発明の目的は、少数の反射鏡を使用して可及 的に均一なエネルギ密度分布を有するレーザ光を 得ることができ、かつ空間的にもコンパクトを構 成のレーザ加工装置を提供することにある。

均一になるように円筒状凹面鏡で集光させる方法 が本発明者らによつて提案されている(特顧昭 53-23525号)。図示された装置は、レーザ光 を異たる方向に2分割して反射させる反射鏡43 と、これらの分割されたレーザ光をそれぞれ反射 させる円筒状凹面鏡41および42とからなり、 該凹面鏡41および42から反射した分割レーザ 光100および101を被加工部材14上の所定 個所52に集光させて加工するものである。との 場合のエネルギ密度分布を第4図(B)に示すが、 エネルギ密度分布は、分割された各レーザ光のX 方向エネルギ密度分布100Aおよび100Bの 和となり、X方向に均一なものとなる。また等温 度線16も被加工部材14の表面と平行になり、 従つて均一な焼入れ加工が可能になり、かつ熱処 理効率も改善される。しかし、このような装置は、 レーザ光を分割するため、分割された個々のレー ザ光につき反射鏡を必要とし、比較的大きな空間 を必要とする。このため、例えば細いパイプの内 面、またはピストンと摺動接触するシリンダ内面

(4)

以下、本発明を図面によりさらに詳細に説明す る。第5図は、本発明に用いる反射鏡の一実施例 を示す斜視図である。この反射鏡は、折線COiD を円または楕円の一部である曲線 0102 に沿つて平 行移動したときできる凹曲面を反射面にもつもの (交叉2次曲面反射鏡と称する)である。この反 射鏡51を第6図に示すように、水平面からある 角度傾斜させて、TEMooモードのレーザ光9を 垂直に入射させると、細長い集光部52を得ると とができる。この集光のようすを矢印A、矢印B 方向から見た図を第7図、第8図に示す。集光部 5 2 において、エネルギ光度の高い入射ビーム中 心部は集光部の両端に導びかれると同時に反射面 が Y1-Y2方向に円または楕円の曲率を有するた め、 Y: - Y2 方向に狭くなり、従来例(第4図) のエネルギ密度分布102と同様にX方向にほぼ 均一なエネルギ密度分布を有するレーザ光を得る ことができる。このような装置において、集光部 5 2 に被加工部材を置き移動させると、深さが均 ーで熱効率の高い熱処理加工を行なうととができ

(5)

る。

次に第9図は、本発明の他の実施例を示すもので、第6図の実施例と同様にレーザ光9を交叉2次曲面反射鏡51に反射させた後、さらに平面鏡53を介して集光部52を被加工部材14上に導びくようにしたものである。被加工部材14の熱加工は集光部52を被加工材上に移動させて行なりが、この場合、被加工材14を移動させてもよい。この実施例においても、ほぼ均一なよいでま、近つて加工深さの均一な、熱効率の高い熱処理加工を行なりことができる。

第10回は、本発明のさらに他の実施例を示す もので、交叉1次曲面平面鏡54と円筒状(また は楕円筒状凹面鏡)55とを用いて集光面52を 得るものである。図において、垂直入射光9は水 平面とある角度αを傾斜させて悩かれた反射鏡 54で反射され、前配凹面反射鏡55に導びかれる。交叉1次曲面反射鏡54は、第11図に示す

(7)

次に本発明装置の使用例を図面に基づいて説明 する。第12図は、入射レーザ光9の径が管径よ りも大きい場合の細管15の内面の焼入れ加工状 ごとく、折線CO1Dを直線O1O2に沿つて平行移動したときにできるV字型凹面を有する。また、凹面反射鏡55は、円筒または楕円筒の1部をを切り出した内面を反射面とし、Y1-Y2方向に一半光の場合、エネルギ密度の面反射鏡54により凹面反射鏡55がY1-Y2方向に出事を有するため、Y1-Y2方向の曲面で発光であれるが、Y1-Y2方向の曲面で発光では、次がにには対ったよりに移動するととにより、かにには均一な焼入れ加工面を得ることができる。

(8)

態を示す説明図である。図において、レーザ光9 はピームエキスパンダー56亿よつて管径より小 さい径の平行レーザ光9Aに転換され、細管15 内の本発明に係る交叉2次曲面反射鏡51により 反射され、管内面上に集光されるが、交叉 2 次曲 而反射鏡51を速度Vで移動させることにより、 管内面を連続的に焼入れ加工することができる。 図面では反射鏡51を矢印方向に移動させる場合 を示したが、反射鏡51を固定して細管15を移 動させてもよい。本実施例においては、管への入 射レーザ光9Aが管の長さ方向と平行であるため、 管長が長くても管内面の任意の位置の焼入れが可 能である利点を有する。また、交叉2次曲面反射 鏡51は、レーザ光9Aの径程度の大きさでよい ため、細径管内面の任意の個所の焼入れ加工が可 能となる。第13図に細管15の焼入れ部15A の断面形状を示すが、焼入れ架さが均一な焼入れ 部断面形状59が得られる。

第14図は、第10図のレーザ加工装置を用いて被加工材(ゴム)14の切断を行なり場合の使

(10)

用例を示す断面図である。との加工装置には、ガス吹付装置60が備えられ、レーザ光の集光部に(矢印方向に)アルゴン等の不活性ガス61が吹き付けられる。とのような装置を用い、レーザ光のビーム出力2KW、走査速度10m/mmで3mm厚さの合成ゴムを切断したととろ、良好な切断面を得るととができた。

以上、本発明によれば、反射鏡、1 個ないし2個で少なくとも1方向のエネルギ密度が均一なレーザ集光部を容易に得ることができ、また装置の主要構成が反射鏡からなるので、レンズのように破損のおそれがなく、レーザ光の高出力化を図ることができる。さらに構造がコンパクトであるため、取扱いが容易であり、従来困難であつた狭隘な加工部位でもレーザ加工が可能となる。

## 図面の簡単な説明

第1図は、ガウス型エネルギ密度分布を有する レーザ光の断面形状およびエネルギ密度分布を示す線図、第2図は、従来のレーザ加工方法の原理 を示す概略構成図、第3図は、第2図の方法によ (11)

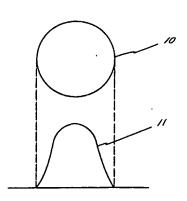
いレーザ光、41,42…円筒状凹面鏡、43… 2分割反射鏡、51…交叉2次曲面反射鏡、52 …集光部、53…平面反射鏡、54…交叉1次曲 面反射鏡、55…円筒状または楕円筒状凹面鏡、 56…ビームエキスパンダ、59…焼入れ部、 100,101…分割されたレーザ光。

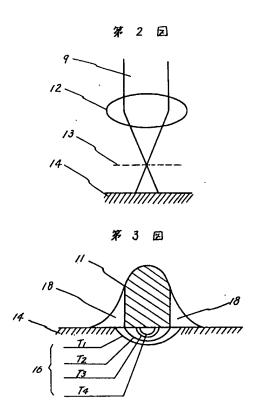
代理人 弁理士 高橋明夫

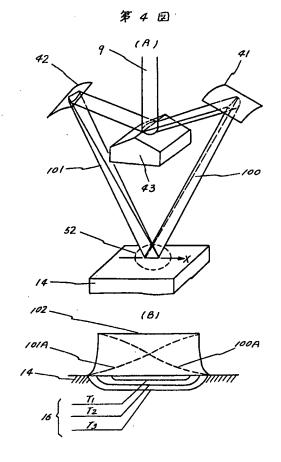
る加熱状況を示す断面図、第4図(A)は、従来の レーザ加工方法の原理を示す概略構成図、第4図 (B)は、その加熱状況の断面図、第5図は、本発 明の與施例に用いる反射鏡の斜視図、第6図は、 本発明に係るレーザ加工方法の実施例を説明する 概略説明図、第7図は、第6図のA矢視図、第8 図は、第5図のB矢視図、第9図は、本発明の他 の実施例を説明するレーザ加工装置の概略構成図、 第10図は、本発明のさらに他の実施例を説明す るレーザ加工装置の概略構成図、第11図は、本 発明の実施例に用いた他の反射鏡の斜視図、第 12図は、本発明装置の使用例を示す図、第13 図は、第12図のレーザ加工装置により焼入れ加 工された管の内面の焼入れ状態を示す断面図、第 14図は、本発明装置の他の使用例を説明する図 てある。

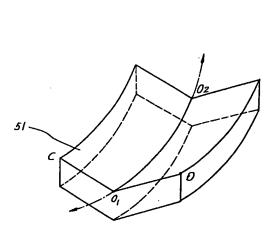
9,9 A … レーザ光、10 … レーザ光断面形状、 11 … エネルギ密度分布、12 … 凸レンズ、13 … 焦点面、14 … 被加工部材、15 … 管内面、 16 … 等温度線、18 … レーザ焼入れに寄与しな (12)

第 / 闰

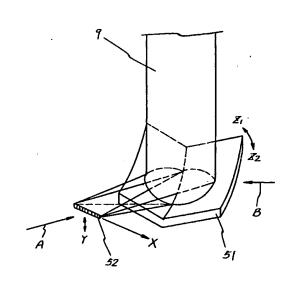








第 5 图



筝 6 回

